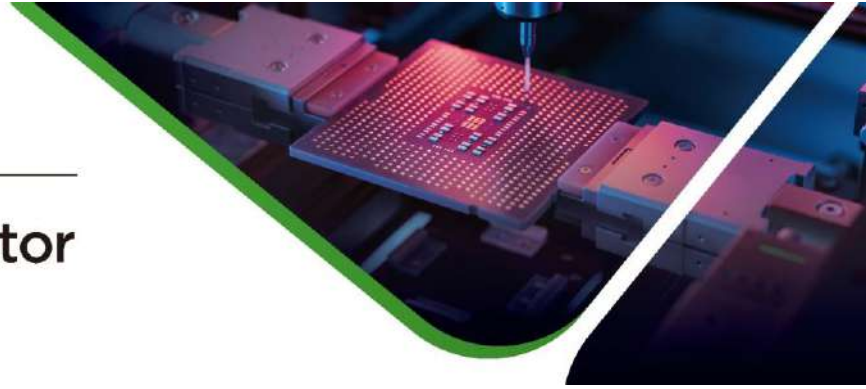
台英半導體聯合培力計畫

UK-Taiwan Semiconductor Joint Skills Project



2027 台英半導體聯合培力計畫

台灣學生代表團徵選簡章

計畫簡介

「台英半導體聯合培力計畫」透過青年人才雙向互訪，結合台灣半導體產業與英國科研創新的優勢，促進人才培育及交流。第一階段已於 2026 年 3 月完成英國學生來台研修；本次第二階段將籌組台灣學生訪問代表團，赴英交流與研習。

本階段由英國政府專案支持（DBSIT, Department for Business, Innovation, Science and Trade）、中華民國外交部支持，遴選 10 名具半導體相關背景的在學碩博士生，於 2027 年 1 月赴英參與約兩週的專業參訪與人才交流。

本計畫旨在協助學生認識英國半導體科研與產業特色，與當地教師、研究人員、學生及產業人才交換觀點，並分享台灣的學習與研究經驗。參與者將以台灣學生代表團成員身分，展現專業素養與交流能力，為兩地持續互動建立人才連結。

台灣端由 SEMI 國際半導體產業協會執行，英國端由英國電子技能基金會（UK Electronics Skills Foundation，UKESF）執行。

交流內容與參與收穫

一、企業與創新平台參訪

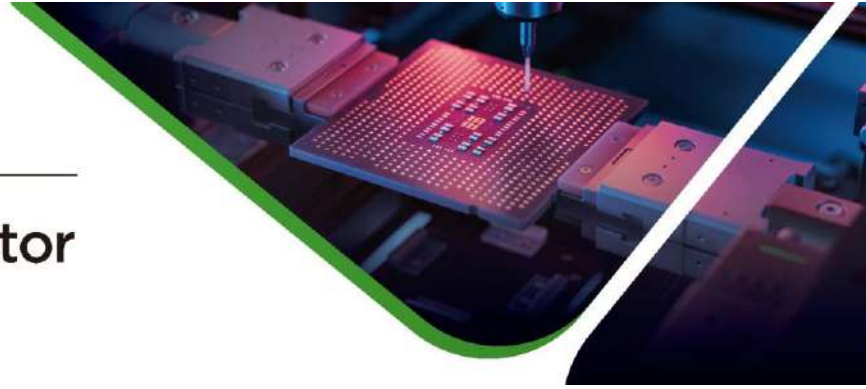
預計走訪 Arm、Paragraf、SiliconCatalyst.UK 等企業與創新平台，了解英國半導體技術、產業應用及新創發展，拓展對全球半導體產業的認識。

二、大學與研究機構交流

預計行程涵蓋倫敦大學學院、劍橋大學、布里斯托大學及南安普頓大學等英國知名學府與半導體研究機構，透過專業參訪及與當地師生交流，認識英國半導體研究特色，拓展學術視野與國際人才連結。

三、專業討論與人才互動

透過專業分享、參訪及討論，與英方人才交流學習、研究及產業經驗。學生將



練習以英語介紹自身專業、提出問題及回應不同觀點，累積跨文化溝通經驗。

四、台灣經驗分享與後續交流

學生將於交流期間分享台灣的學習、研究、產業與文化觀察；返台後須 30 日內繳交交流心得（1,000 字）並參與至少一場分享活動，形式及期限於行前說明會確認。SEMI 將邀請參與者加入 SEMI 學生社群，持續接觸產業資訊及交流機會，是否加入由個人自行決定。

本計畫以專業參訪、研習及人才交流為主，各單位的活動形式依接待安排而定。所列參訪單位為暫定安排，以最終行程為準，完整行程於錄取後提供；執行單位得依接待情形調整參訪單位與活動內容。

出訪期間與名額

出訪期間：2027 年 1 月 15 日至 1 月 30 日，包含往返飛行時間；實際起降及抵台時間依航班安排通知。

甄選名額：正取 10 名、備取 5 名；未達甄選標準時，得不足額錄取。

申請資格

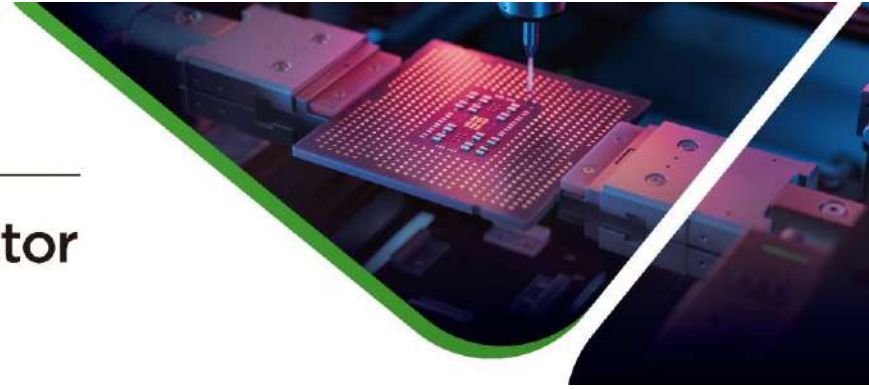
一、國籍與在學身分

申請者須具中華民國國籍，於報名時及出訪期間就讀台灣大專校院碩士班或博士班，且未擔任全職正職工作；實習（含已取得之實習 offer）及校內研究助理、教學助理不在此限。在職專班（含 EMBA）、已畢業或休學者不符合資格。碩士班一年級學生亦可申請。

二、科系與專業背景

就讀電機工程、電子工程、光電工程、資訊工程、材料科學與工程、物理、應用物理、化學、化學工程、半導體工程等相關碩博士班，具備半導體相關修課、研究或專案經驗，能理解專業參訪內容並參與討論。

其他系所學生，如具備與半導體相關的專業背景，亦可申請。相關經驗包括半導體元件、晶片與電路設計、電子材料、製程、封裝、光電、功率電子，或應



用於半導體及晶片的人工智慧與運算技術等，請於報名資料中具體說明。

三、英語能力

須提供下列任一英語檢定成績，測驗日期介於 2024 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 13 日，並於報名截止前提交證明：

- TOEIC 測驗：總分 785 分以上，且聽力至少 400 分
- IELTS 測驗：總分 6.0 以上，且聽力、口說各至少 5.5
- TOEFL iBT 測驗：2026 年 1 月 21 日前應試者，總分至少 72 分、聽力至少 13 分、口說至少 16 分；自該日起應試者，總分至少 4 分、聽力及口說各至少 3 分（新制，1–6 分級）
- 全民英檢：中高級複試通過，以複試測驗日期認定

檢定成績用於資格初審；面試另測試申請者能否以英語介紹自身經驗、理解問題及參與討論。面試英語表現須達標準，未達者不予錄取。

四、參與意願與團隊合作

願意主動學習、與團員合作，並尊重不同文化與觀點。

計畫提供與自理費用

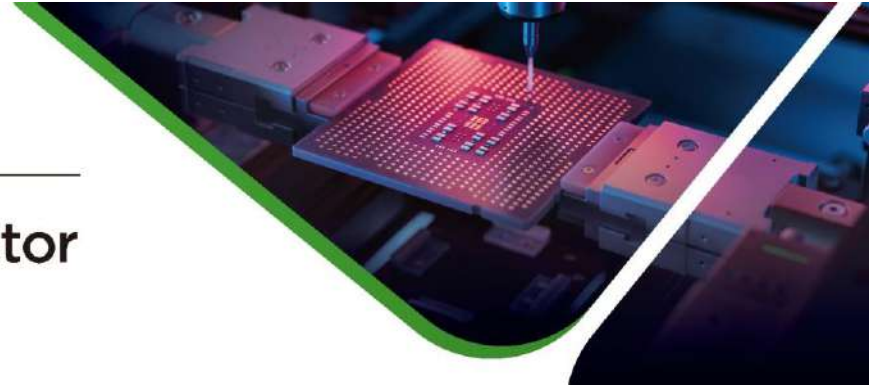
本計畫統一安排主要旅運及週間官方行程，學生自行負擔私人支出與假日自由活動費用。

計畫提供	學生自理
團體往返機票、行程期間住宿（含假日）、週間研習及參訪安排、依團體行程安排的交通與餐食、英國簽證及旅遊保險	往返桃園機場的交通、假日自由活動的交通、餐食及門票，以及個人購物、通訊網路與其他私人支出、護照申請或換發費用

上述費用由計畫統一安排，不以現金發放。假日住宿仍由計畫提供；自由活動須遵守代表團管理規範。簽證與保險所需之護照及相關資料，將於錄取後另行蒐集。

台英半導體聯合培力計畫

UK-Taiwan Semiconductor Joint Skills Project



報名方式與資料

請於 2026 年 11 月 13 日（五）中午 12:00 前完成線上報名，提交履歷、在學證明、成績單及英語檢定證明。題目與附件要求詳見報名表『選填：作品集或佐證連結（例如專題成果、GitHub、論文、技術部落格）』，不提供不影響書審評分。請僅提供與專業學習、研究或交流相關的公開內容，並避免包含他人個人資料、公司機密或未公開技術。

截止前可補件或修改；截止後不受理。資料不完整或資格不符者，不予受理。

經教授推薦的同學，推薦人須於報名截止日前填寫完成。

報名連結： https://forms.gle/mHSume2waRaaqY4NA

個人資料之蒐集目的、使用範圍及保存期限，詳見報名表之個資告知。

甄選方式與時程

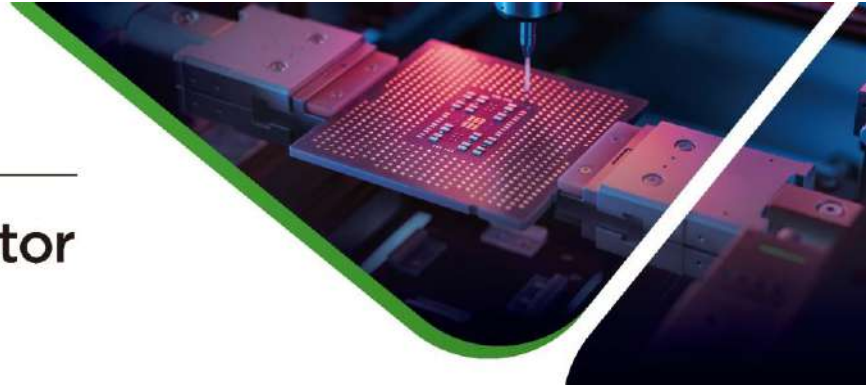
甄選分為書面審查與面試。產業評審依報名資料，綜合評估專業力、發展潛力、主動與積極度及台灣經驗分享意願。以書審成績前 20 名進入面試，同分者一併進入。通過書審者由 SEMI 面試，確認英語溝通能力與申請內容。未通過面試英語門檻者不予錄取。其餘依書審 80%、面試 20% 的加權總成績擇優錄取。

日期	作業內容
即日起至 2026/11/13	開放報名
2026/11/16–11/24	書面審查
2026/11/25–11/27	通知書審結果及面試安排
2026/11/30–12/2	面試，以實體或線上方式辦理
2026/12/7	公告正取及備取名單
錄取後至出發前	參與行前說明會及完成出訪準備，時間另行通知
2027/1/15–1/30	赴英交流與研習

錄取者須於 2026 年 12 月 14 日內確認參與；逾期未確認或放棄者，由備取依序遞補。

台英半導體聯合培力計畫

UK-Taiwan Semiconductor Joint Skills Project



參與義務與注意事項

- 錄取者須參加行前準備、全程隨團自台灣出發及返回，遵守團體與接待單位規範，並完成學習紀錄及返台成果分享。成果要求詳見「交流內容與參與收穫」第四點。
- 錄取者須持效期至 2027 年 7 月 30 日以後之中華民國護照。
- 自由活動依行程安排；週末如有團體活動或移動，仍須配合。
- 確認參與前，錄取者須於期限內簽署參與同意書，內容包含行前配合事項、退出及費用責任，以及影像授權。
- 行程中將拍攝照片與影片，用於計畫推廣。肖像授權將於參與同意書中另行勾選，不同意者不影響錄取資格，但團體拍攝仍可能入鏡。
- 返台後一年內，SEMI 得邀請參與心得分享或交流活動，時間依課業安排協調，交通等費用由 SEMI 負擔。
- 行程如因航班、接待安排或不可抗力調整，由 SEMI 通知。
- 您的報名資料將提供本計畫產業評審審閱，僅供本次甄選使用。錄取者之資料將提供英國端 UKESF 及外交部，用於簽證、保險及行程安排。資料保存至計畫結束後 1 個月，期滿刪除。您得依個資法行使查詢、更正、刪除等權利，聯絡方式同下。

聯絡窗口

SEMI 國際半導體產業協會 | Ily Tsai
電子郵件：itsai@semi.org
電話：03-560-1777 分機 508

SEMI 國際半導體產業協會 | Nicole Liao
電子郵件：nliao@semi.org
電話：03-560-1777 分機 510